경제혁신

산업통상자원부 MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

보 도 자 료

희망의 새시대

http://www.motie.go.kr

**2015년 10월 30일(금) 조간부터** 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 10.29(목) 오전 11시 이후 보도 가능)

문의 : 산업통상자원부 전자부품과 과장 김정화(044-203-4270), 이시몬 사무관(4275)

# 과거의 도전정신을 기억하며 반도체산업 재도약하자

## - 제8회 반도체의 날 기념식 개최 및 반도체산업 유공자 포상 -

□ 우리 경제여건이 어려운 상황에서도 반도체산업은 '수출경쟁력 강화 대책'의 핵심 과제인 선제적인 대규모 투자를 통해 산업 주도권 유지 노력에 앞장서는 한편,

○ 신기술 개발 등을 통해 반도체산업 주도권을 유지해 나가고 있으며, 수출도 지속적으로 호조세를 나타내고 있다.

* 삼성전자 평택공장 건설(15.6조원), SK하이닉스 이천·청주 공장 투자계획 발표(총 31조원)
* 반도체 수출 : '14년 626억불(전체의 10.9%), '15년 1~9월 474억불(전체의 12%) / 16개월 연속 증가세

□ '15.10.29일(목), 서울 코엑스 인터콘티넨탈호텔에서는 반도체산업 종사자들이 함께 모여 이러한 성과를 자축하고 노고를 격려하는 축제의 장인 「제8회 반도체의 날」이 열렸다.

* 「반도체의 날」은 반도체 수출이 최초로 100억불을 돌파한 1994년 10월을 기념하여 2008년부터 개최되었음

○ 이 날 기념식에는 이관섭 산업통상자원부 차관, 김기남 반도체산업협회장(삼성전자 사장) 등 산·학·연 관계자 500여명이 참석하였으며,



○ 행사에 참석한 산·학·연 관계자들은 세계 거대 시장인 중국이 반도체 산업을 집중 육성하는 등 대외적 여건이 녹록치 않으나, 끊임없는 도전과 기술혁신을 통해 어려운 상황을 극복하자는 데 뜻을 모았다.

□ 이관섭 차관은 축사를 통해 우리나라 반도체산업의 성과를 격려하고, 반도체산업 초창기의 과감한 도전정신을 살려 시스템반도체 등 성장이 유망한 영역에서도 저력을 발휘하자고 하면서,

○ 정부는 '수출 경쟁력 강화 대책'의 일환으로 기업의 투자 확대를 위하여 다각적으로 지원하고,

○ '제조업 혁신 3.0 전략'과 연계하여, 대학 인재들이 신산업 분야에서 창의성과 도전정신을 발휘할 수 있도록 시스템반도체 분야의 기술 개발, 고급 인력 양성 등에 중점 지원하겠다고 밝혔다.

□ 또한, 반도체의 날을 맞아 우리나라 반도체산업 발전에 공적을 남긴 유공자 37명에 대한 정부 포상도 있었다.

○ 은탑산업훈장은 열악한 반도체장비 분야에서도 전공정장비 Dry Strip* 분야 세계시장 점유율 1위를 차지하고 있는 피에스케이 박경수 대표가 수상하였다.

* 반도체공정 중 웨이퍼 위 패턴 형성과정에서 도포된 감광액을 제거하는 공정

○ 손보익 LG전자 전무가 3D TV칩 개발 등을 통해 수출에 기여한 공로로 동탑산업훈장을 받았고, 세계 최초로 14나노 핀펫(finfet) 이라는 신소자 개발을 주도한 심상필 삼성전자 상무가 산업포장을 받았다.

○ 이 밖에도 대통령 표창 2명, 국무총리 표창 3명, 산업통상자원부 장관 표창 29명에게 포상을 수여했다.

< 반도체 산업발전 정부포상 대상자 >

| 구 분 | 훈 격 | | 규모 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 정부 포상 (37점) | 산업 훈장 | 은탑 | 1 | 박경수 대표(피에스케이) |
| | | 동탑 | 1 | 손보익 전무(LG전자) |
| | 산업포장 | | 1 | 심상필 상무(삼성전자) |
| | 대통령표창 | | 2 | 안진호 교수(한양대), 조명관 상무(SK하이닉스) |
| | 국무총리표창 | | 3 | 김범석 상무(동부하이텍), 정상곤 부사장(기가레인), 김준석 대표(에이디테크놀로지) |
| | 장관표창 | | 29 | 최광락 상무(케이씨텍) 등 29명 |

< 별첨 1 > 제8회「반도체의 날」기념식 개요
< 별첨 2 > 정부포상 수상자 명단

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 김정화 과장(☎ 044-203-4270), 이시몬 사무관(☎ 044-203-4275)에게 연락주시기 바랍니다.



MIN TRA

## 참고1 제8회「반도체의 날」기념식 개요

### □ 개최배경

○ 국가 주력산업인 반도체산업의 **성과와 위상을 대외에 홍보**하고, 반도체 **산·학·연의 노고를 격려**하는 기념식 개최

* '반도체 수출 100억불 달성('94.10.29)을 기념하여 제정, '08년 1회 행사 개최

### □ 개요

○ **일시** : **'15.10.29(목)** 18:00~20:00

○ **장소** : **코엑스인터컨티넨탈호텔** 하모니볼룸(B1)

○ **참석자** : **산업부 차관**, 노영민 의원, 삼성전자 김기남 사장(협회장) 등 산·학·연 관계자 500여명

### □ 주요 행사내용

| 구 분 | 시간 | 주요 내용 | |
|---|---|---|---|
| opening | 18:00~18:03 | ▪ 오프닝 영상 | |
| 기념식 | 18:03~18:55 | ▪ 1부 기념행사 | |
| | 18:03~18:08 | 국민의례 및 VIP 소개 | ▪ 국민의례, 참석 내/외빈 소개 |
| | 18:08~18:13 | 환영사 | ▪ 한국반도체산업협회 회장 |
| | 18:13~18:18 | 축 사 | ▪ **산업통상자원부 차관** |
| | 18:18~18:33 | 유공자 정부포상 | ▪ **정부포상(37)**<br>- **은탑훈장(1), 동탑훈장(1), 산업포장(1), 대통령 표창(2), 국무총리 표창(3), 산업부장관 표창(29)** |
| | 18:33~18:43 | 유공자 민간포상 | ▪ 협회장상(20) |
| | 18:43~18:50 | 반도체 장학금 수여식 | |
| | 18:50~20:00 | ▪ 2부 축하 리셉션 | |
| | 18:50~19:00 | 건배사 | ▪ 노영민 의원, 업계 원로 등 |
| | 19:00~19:55 | 만 찬 | ▪ 축하 공연 및 만찬 |
| | 19:55~20:00 | 폐회선언 | ▪ 폐회 선언 |

## 참고2 정부포상 수상자 현황

□ **정부 포상** : 훈장(은탑1, 동탑1), 산업포장(1), 대통령표창(2), 국무총리표창(3), 산업부장관표창(29) 등 총 37점

| 포상훈격 | 대상자 | 소속 및 직급 | 성명 | 공적 개요 |
|---|---|---|---|---|
| 산업훈장(은탑) |  | 피에스케이 대표이사 | 박경수 | ·반도체 제조용 핵심 전공정장비 세계시장 점유율 1위 달성<br>·반도체산업 장비/부품분야 기반조성 및 국산화율 제고 |
| 산업훈장(동탑) |  | LG전자 전무 | 손보익 | ·3D TV 칩 등 기술개발을 통하여 수출 증가에 기여<br>·국내 팹리스기업 및 대학과의 협업을 통하여 시스템반도체 분야의 초석 마련 |
| 산업포장 |  | 삼성전자 상무 | 심상필 | ·세계 최초 모바일용 신소자 제조기술(14nm핀펫) 개발 성공<br>·기술 라이센스를 통한 로열티 수입 창출 |
| 대통령표창 |  | 한양대학교 교수 | 안진호 | ·반도체분야 고급인력 양성 및 건전한 생태계 조성<br>·국내 최초 차세대 반도체 제조 핵심기술(EUV) 개발 성공 |
| |  | 에스케이 하이닉스 상무 | 조명관 | ·메모리반도체(NAND)분야 세계 최초 16nm급 TLC 제품개발<br>·해외시장 판로 개척 및 수출 증대에 기여 |
| 국무총리표창 |  | 동부하이텍 상무 | 김범석 | ·시스템반도체분야(Display Driver IC) 독자 제조기술 개발<br>·시스템반도체분야 학술대회를 통한 교류 강화/확산 |
| |  | 기가레인 부사장 | 정상곤 | ·반도체 제조용 핵심장비(식각장비) 국산화 및 세계화 선도<br>·친환경 LED 식각장비 개발을 통한 환경 개선/에너지 절감 |
| |  | 에이디 테크놀로지 대표이사 | 김준석 | ·반도체설계 프로세스 표준화 및 선행기술 확보<br>·지속적인 연구개발 투자를 통해 차세대 디스플레이용 인터페이스 칩 등 국산화 개발 성공 |



| 포상훈격 | 소 속 | 직급 | 성명 | 공적 개요 |
|---|---|---|---|---|
| 산업부장관표창(14/29) | 코리아 인스트루먼트 | 부사장 | 오태엽 | ·국내 메모리반도체 산업발전 및 웨이퍼 테스트 장비 및 주요 핵심부품 국산화 성공 |
| | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 | 전무 | 박광선 | ·반도체산업 대중소기업 상생협력 및 동반성장을 위한 협력사 발굴, 투자유치, 기술지도·이전 |
| | 케이씨텍 | 상무 | 최광락 | ·해외에서 전략 수입에 의존하던 반도체장비(CMP)의 국산화 성공 및 수입대체 효과를 통한 국가 경제발전 |
| | 엑시콘 | 수석 | 이창원 | ·반도체 제조설비 연구개발 및 반도체 검사장비의 국산화를 통한 기술경쟁력 확보 |
| | 노블테크 | 대표이사 | 김용기 | ·시스템반도체와 메모리반도체의 융합제품 개발 성공 |
| | 미코 | 상무 | 전영곤 | ·반도체 세라믹 부품의 국산화 성공 (Y2O3/AlN 세라믹 핵심부품) |
| | 한국반도체 산업협회 | 책임 | 탁승수 | ·반도체의 날 제정, 반도체산업 50년 역사서 편찬 및 판교반도체회관 건립을 통한 산업기반 조성 |
| | 삼성전자 | 상무 | 김치욱 | ·최첨단 D램 개발을 통한 세계시장 점유율 40% 돌파(1위), 매출 29조원 달성 |
| | 에스케이 하이닉스 | 수석 연구원 | 조주환 | ·세계 최초 20나노미터급 고용량, 저전력 메모리반도체 개발 |
| | 서울대학교 | 교수 | 이혁재 | ·시스템반도체 설계분야 연구를 통해 200여 편의 논문 발표, 20여건의 국내외 특허 출원·등록 |
| | 실리콘 마이터스 | 연구위원 | 장일권 | ·국내 최초 모바일용 시스템반도체, 배터리 관리 시스템반도체 국산화 |
| | 한국전자통신 연구원 | 책임 연구원 | 문재경 | ·전력용 반도체 기술개발 및 국산화, 고효율·고전력·고출력의 반도체 칩 설계 기술개발 성공 |
| | 전자부품연구원 | 책임 | 민경원 | ·국가 반도체 전략 수립 및 핵심기술 보호, 기술개발협력을 통한 중소기업 육성 |
| | 실리콘웍스 | 이사 | 나준호 | ·S램 및 D램 개발을 통한 반도체산업 발전 및 디스플레이용 시스템반도체 개발 |

| 포상훈격 | 소 속 | 직급 | 성명 | 공적 개요 |
|---|---|---|---|---|
| 산업부 장관표창 (15/29) | 원익 아이피에스 | 상무 이사 | 류동호 | ·국내 최초 더블 패터닝용 PE ALD장비 국산화 성공 |
| | 전북대학교 | 교수 | 심규환 | ·방호용 특화반도체 개발·상용화를 통해 에너지, 통신산업 등에 적용 |
| | OCI 머티리얼즈 | 상무 | 최병찬 (63.09.07) | ·반도체, LCD 제조 공정의 필수 소재인 삼불화질소의 제조, 정제 기술개발 성공 |
| | 서강대학교 | 부교수 | 최우영 | ·초저전력 반도체 소자 및 삼차원 FPGA를 세계 최초로 개발 |
| | 주성 엔지니어링 | 부장 | 유진혁 | ·반도체 제조장비(CVD) 국산화 및 극저온 SiO장치 개발 성공 |
| | 이오테크닉스 | 부장 | 현병훈 | ·반도체 제조용 레이저 마킹기, 국산화 레이저 상품화, 메모리카드 레이저 커터 등 기술개발 |
| | 숭실대학교 | 부교수 | 이성수 | ·시스템반도체 연산량 및 소모전력을 절감시키는 기술개발 |
| | 시노펙스 | 차장 | 배광일 | ·반도체 CMP공정용 슬러리 필터 국산화 성공, 수입대체 |
| | 에프씨아이 | 상무 이사 | 임규현 | ·무선 이동 통신용 RF시스템반도체 독자 제조기술 개발을 통해 칩 개발 |
| | 성균관대학교 | 부교수 | 이강윤 | ·산학협력을 통한 시스템반도체산업 발전 및 실무형 설계인력 양성 |
| | 유피케미칼 | 부장 | 성다경 | ·국내 최초, 세계에서 두 번째로 반도체 제조용 특수재료(STI gap-fill용 SOD)의 개발 성공 |
| | 한국과학 기술원 | 책임 | 이의숙 | ·반도체분야 설계인력 양성을 위한 환경 지원 및 정부정책 수립 지원 |
| | 삼성전자 | 수석 | 차상엽 | ·반도체장비재료성능평가사업 전문위원 활동을 통해 장비 국산화 지원 |
| | 에스케이 하이닉스 | 수석 | 이해정 | ·반도체 장비 및 재료 업체의 기술력 향상 및 동반성장 지원 |
| | 영창케미칼 | 사장 | 이승훈 | ·반도체 소재 분야 국산화 및 신제품 개발 성공 |